■第12回電子デバイスフォーラム京都プログラム（KM-1 挨拶・基調講演：西地区4号館地下1階 バズホール、KM-2、A～Eコース：東地区1号館）

（敬称略）

10月30日(木)10:00-12:30

KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30
（受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始）

司会：中村 孝(大阪大学)

◆来賓挨拶
京都府知事 （予定）
京都市長 （予定）

◆基調講演
「日本半導体復活戦略(仮題)」
経済産業省(予定)

◆基調講演：
「島津製作所の注力分野(仮題)」
㈱島津製作所 経営戦略室 室長 岩切 省吾郎

◆基調講演
「AIと自動車アプリをコアに2030年の
電子デバイス産業は200兆円に！！」
㈱産業タイムズ社 取締役会長 泉谷 渉

10月31日(金)9:20-11:45

KM-2 マーケティングセッション 9:20-11:45 （受付 8:50 開始）

司会：廣田良浩(ワイドヴィル)

◆特別講演
「混迷深まる世界情勢における半導体・装置・電子部品市場見通し」
㈱産業タイムズ社 大阪支局 支局長
電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛

◆特別講演
「グローバル市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し(仮題)」
インフォーマインテリジェンス合同会社
シニアコンサルティングディレクター 南川 明

◆特別講演
「テクノロジーハードウェア業界見通し：スマホなど完成品・AIサーバー需要見通し、FPDやCMOSセンサなど部品視点も」
みずほ証券㈱ エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ、シニア・アナリスト 中根 康夫

コース

【A】新世代モビリティ

【B】話題の新技術

【C】The 半導体

【D】跳躍の最先端パッケージ・実装技術

【E】特別セッション

10月30日(木)14:00-16:40

A-1 特別企画
戸所義博(イーセップ)/山崎治(シャープフロンティアAT)

新たな変革を迫られる自動車業界

◆自動車業界全体の市場推移と将来予測(仮題)
PwCコンサルティング合同会社（講演者調整中）
◆xEV技術とその進化を支えるパワエレ、パワーデバイスの進化(仮題)
トヨタ自動車㈱、㈱ミライズテクノロジーズ 堀田 幸司

B-1 ロボティクス
酒井滋樹(日新イオン機器)/平澤拓(パナソニック)

◆ヒューマノイドロボットとサービスロボットの
技術者から見たビジネス展望
㈱シンクロボ 代表取締役社長 小倉 崇
◆エッジAIが実現する"器用な"ロボット。Thinkerがもたらす
現場のシンカ(仮題)
㈱Thinker CTO 中野 基輝
◆(調整中)

C-1 EUV、つ・い・に・日本上陸、今その技術 の全貌が・・・
山本浩之(マイクロン)/廣田良浩(ワイドヴィル)

◆先端EUVリソグラフィ技術(仮題)
ASMLジャパン㈱ テクニカル マーケティング ディレクター 永原 誠司
◆EUVレジストの軌跡と更なる飛躍
JSR㈱
電子材料事業部 精密電子開発センター長 丸山 研
◆High NA EUV量産に向けた先進的な塗布現像装置の技術
東京エレクトロン九州㈱ プロセス技術部
CT基礎開発グループ グループリーダー 塩澤 崇博

D-1 技術・マーケットトレンド [13:50-16:45]
森川泰宏(ULVAC)/藤原健典(東レ)

◆半導体実装技術・マーケットトレンド(仮題)
㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦
◆ラピダスの実装戦略(仮題)
ラピダス㈱ 3Dアセンブリー本部 フェロー 野中 敏央
◆半導体PKGの動向(仮題)
日本サムソン㈱ 古谷 俊樹
◆光電融合の実装技術(仮題)
慶応義塾大学理工学部 物理情報工学科 教授 石榑 崇明

E-1 大学セッション(無料) [13:50-16:45]
データ活用による、研究～製造の今後の展開
今本浩史(京都大学)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)

◆IoTビッグデータのためのAI技術
大阪大学 産業科学AIセンター センター長 教授 櫻井 保志
◆有機エレクトロニクス研究のラボオートメーション
山形大学 有機エレクトロニクス研究センター
教授 兼 副センター長 松井 弘之
◆電子ラボノートを基盤とした研究DXの推進と
データ駆動型サイエンスの社会実装
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域
マテリアルズ・インフォマティクス研究室 助教 高須賀 聖五
◆オープンサイエンスとデータ駆動型研究を推進するための京都大学の取り組み
京都大学 情報環境機構 データ運用支援基盤センター
センター長・教授 溫美 紀寿

10月31日(金)12:35-14:50

A-2 SDV/自動運転
松浦正純(FLOSFIA)/山崎治(シャープフロンティアAT)

◆SDV開発に向けた仮想環境プラットフォーム
㈱デンソー ソフト生産革新部 上級キャリアエキスパート 岩井 明史
◆自動運転に向けた車載SoC(仮題)
インフォーマインテリジェンス合同会社
プリンシパルコンサルタント 鈴木 寿哉
◆ドライブレコーダの動向(仮題)
(一社)NNCモビリティ 理事 久保 登

B-2 サーマルエンジニアリング
平澤拓(パナソニック)/泉谷淳子(村田製作所)

◆データセンターの放熱/冷却技術の最新動向(仮題)
㈱ サーマルデザインラボ 国峯 直樹
◆半導体パッケージの熱シミュレーションモデルの国際規格(仮題)
パナソニックインダストリー㈱ 熊野 豊
◆薄型ペイパーチャンバーの性能向上に向けた設計について(仮題)
㈱村田製作所 玉山 孟明

C-2 進化し続けるデバイス構造・プロセス技術・装置技術
森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル)

◆最先端のロジック半導体のトランジスタ技術の進化(FinFET からGAA
そしてCFETへ)(仮題)
東京大学 生産技術研究所 教授 平本 俊郎
◆3次元フラッシュメモリにおけるメタライゼーションとCMOS Directly
Bonded to Array(CBA)技術
キオクシア㈱ 先端メモリ開発センター 先端メモリ研究開発部
グループ長 田上 政由
◆AI時代の半導体パッケージ技術：巨大化と微細化を支える露光装置の重要性
㈱SCREENアドバンストシステムソリューションズ
フロンティア技術統轄部 露光プロダクト部 長尾 竜也

D-2 光電融合
不破保博(元ローム)/藤原健典(東レ)

◆NTTの光電融合戦略(仮題)
日本電信電話㈱ 先端集積デバイス研究所 フェロー 松尾 慎治
◆異種材料接合を用いたInP/Siフォトニクス光集積回路技術
住友電気工業㈱ 伝送デバイス研究所
主幹・シニアスペシャリスト 八木 英樹
◆AIデータセンター時代を支える多心光コネクタ技術の最前線
㈱白山
取締役 マーケティング・事業開発最高責任者 金原 竜生

E-2 AI・ニューロモーフィック半導体
浦岡行治(NAIST)/中村孝(大阪大学)

◆AIチップとデバイス技術の進化：インメモリコンピューティングの
可能性
日本IBM㈱ 東京基礎研究所
シニア・リサーチ・サイエンティスト 岡崎 篤也
◆AIをハードウェアで実現するニューロモーフィックシステム
龍谷大学 先端理工学部 教授 木村 睦
◆有機フローティングゲートメモリの開発と人工シナプスデバイスへの
応用(仮題)
大阪公立大学 准教授 永瀬 隆

10月31日(金)15:15-17:30

A-3 パワーデバイス
松浦正純(FLOSFIA)/中村孝(大阪大学)

◆車載向けSiCパワーデバイスの市場動向(仮題)
㈱矢野経済研究所
インダストリアルテクノロジーユニット 主任研究員 池山 智也
◆データセンター向けサーバー用高機能CPU/GPU・パワーデバイス冷却
相変化型冷却器サイフォレックスの紹介
住友精密工業㈱ データセンターサーマルソリューションプロジェクトチーム
マネージャー 花房 翔大
◆SiCパワーデバイスの現状と将来展望
国立研究開発法人産業技術総合研究所
先進パワーエレクトロニクス研究センター 研究センター長 田中 保宣

B-3 光通信技術・応用
妹尾和則(NTT研究所)/泉谷淳子(村田製作所)/

◆LNの光変調器応用と薄膜LN技術による高速化及び高集積化
古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ㈱
オプティカルコンポーネンツ事業部 マネージャー 牧野 俊太郎
◆光ディスアグリゲーテッドコンピューティングの現在地(仮題)
NTT㈱ 村中 勇介
◆冷却原子化型量子コンピュータが創る産業とその展望(仮題)
㈱Yaqumo 中小司 和弘

C-3 AI 時代を支え進化し続ける半導体デバイス技術、設計技術
山本浩之(マイクロン)/三冨士道彦(ローム)

◆AI時代における半導体設計革新とデジタルツインの可能性
シーメンスEDAジャパン㈱ 技術本部 本部長 丁子 和之
◆LPDRAM Evolution: LP6 and beyond
マイクロンメモリジャパン㈱ DRAM Engineering Group
LPDDR Design Engineering SR Director 石川 透
◆CBA(CMOS Directly Bonded to Arrey)技術による
3次元フラッシュメモリの高性能化
キオクシア㈱ メモリ開発戦略部 メモリ開発戦略第二担当 参事
小林 茂樹

D-3 先端PKG
不破保博(元ローム)/森川泰宏(ULVAC)

◆GLコアの動向(仮題)
大日本印刷㈱ 藤本 興治
◆先端半導体パッケージサイズ拡大における
モールディング技術の動向
TOWA㈱ 市場開発部 営業技術課 シニアリーダー 寺本 翔太
◆先端半導体パッケージ向けガラス基板用TGV用シード層および
硫酸銅めっきの開発動向
奥野製薬工業㈱ 総合技術研究部
基板半導体領域 領域長 吉川 純二

E-3 やはり目が離せない！ アジア半導体産業の動き 中・韓・印 アジア半導体産業の最前線を追う！
戸所義博(イーセップ)

◆中国・インド 半導体産業の現在地(仮題)
㈱産業タイムズ社 代表取締役副社長
電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏

◆韓国の半導体育成戦略(仮題)
㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 嚴 在漢